

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-072

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

# 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划和战略实施的需要，2025 年度公司拟向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 3 亿元（包括 3 亿元）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），期限为 12 个月。上述额度在授权期限内可以循环使用，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、包含融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

公司以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保，具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

公司实际控制人崔学峰先生、龙波先生等关联自然人拟根据实际需要为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保、反担保，具体担保、反担保的金额及期限以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的授信协议、借款协议、担保协议为准，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》中上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

### 二、担保方基本情况

崔学峰先生、龙波先生为公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，崔学峰先生、龙波先生不属于失信被执行人。

### 三、相关决策程序

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的审议结果通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日